

# 第77期 報告書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで



SHINKO

新光電気工業株式会社



# 株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より当社事業運営にひとかたならぬご支援を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、第77期報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげます。

スマートフォンをはじめとする多機能携帯情報端末市場の拡大や、新興国を中心とするパソコン・デジタル家電等の需要拡大、さらにはカーエレクトロニクス分野のさらなる発展なども背景として、半導体産業は、今後、中長期的な成長の持続が見込まれます。

一方で、高集積化・高速化等の技術革新および絶えず変化する市場ニーズに対し、低コストかつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、生き残りをかけた世界規模での競争が、さらに一段と激化することが予想されます。

当社グループは、このような産業にあって、徹底した現場主義により「ものづくり」のすべての段階において革新をはかり、変化に即応できる企業体質の構築を目的として、一層の合理化・生産性の向上に努めてまいります。また、長期的視点で革新的な技術の開発に取り組むとともに、お客様のニーズに即した新製品の開発・量産化を進め、競争力の向上ならびに収益の確保に努めてまいります。

## ■ 平成23年度の事業概況

### 世界経済の減速懸念が高まる エレクトロニクス機器向けの需要が弱含む

当期の経済環境は、日本におきましては、東日本大震災後の混乱に加え、極端な円高・ドル安傾向の長期化等により、生産・輸出・消費が大きく落ち込むなど、総じて厳しい状況で推移しました。海外では、欧州における金融不安、米国経済の回復鈍化、タイにおける洪水被害、さらには中東の政治不安等に起因する原油価格の高騰などを背景に景気の減速懸念が高まる状況となりました。

半導体業界につきましては、スマートフォンやタブレット端末等が需要を牽引したものの、世界経済が減速感を強める中、タイの洪水被害の影響による一部製品の供給不足懸念なども背景として、パソコンや薄型テレビ等、エレクトロニクス機器向けの需要が弱含むなど、厳しい市場環境のうちに推移しました。

### 主力製品の生産能力増強・次世代製品対応への投資 在庫調整・円高ドル安長期化の影響

このような環境下において、当社グループにおきましては、主力のフリップチップタイプパッケージの生産能力増強・次世代製品対応のための投資をはじめ、今後、成長が見込まれる製品分野において重点的に経営資源の投下をはかるとともに、積極的な拡販活動によって受注確保に努め、海外向けを中心に受注は第4四半期にかけて回復傾向を示したもの

の、総じてパソコンやデジタル家電等の需要伸び悩みに伴う在庫調整の影響を受けたことなどにより、当期の連結売上高は1,258億25百万円(対前期比10.7%減)となりました。収益面につきましては、厳しい事業環境のもと、全社において生産革新活動を基軸とする合理化・効率化の一層の強化ならびに経費削減等の緊急対策を実行したものの、市場価格の低下に加え、円高・ドル安の長期化による影響を大きく受けたことなどから、遺憾ながら、連結ベースの経常損失は17億58百万円、当期純損失は22億42百万円となりました。

単独決算につきましては、売上高1,204億38百万円(対前期比10.9%減)、経常損失18億95百万円、当期純損失21億65百万円を計上いたしました。なお、当期の配当につきましては、期末配当金を10円とし、中間配当金の10円とあわせて年間20円とさせていただきます。

## ■ 今後の見通し

### 世界経済の停滞に伴う需要伸び悩み 高品質かつ低コスト化への要求の強まり

今後の半導体業界におきましては、引き続きスマートフォン等の多機能携帯情報端末の市場拡大や、新興国におけるパソコン・デジタル家電等への需要拡大が期待されるものの、世界経済の停滞に伴う需要の伸び悩みが懸念されるほか、高品質かつ低コスト化への要求がさらに強まり、企業間競争の一層の激化が見込まれるなど、今後も厳しい市場環境が続くものと想定されます。

### マーケティング機能・商品開発力の一層の充実 市場・環境の変化に即応できる企業体質の確立

当社グループといたしましては、マーケティング機能ならびに商品開発力の一層の充実に努め、当社が有する最先端の半導体実装技術をもとに、お客様のニーズに即した新商品のタイムリーな市場投入・事業化をはかることによって、経営基盤の強化に注力してまいります。また、熾烈な競争が繰り広げられる半導体市場にあって、「限りなき発展」を果たすべく、全社におきまして生産革新活動による生産性向上の取り組みを一段と進化・発展させ、卓越した「ものづくり」の製造現場を構築することにより、市場・環境の変化に即応できる強固な企業体質の確立に努め、収益構造の再構築をはかってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年6月



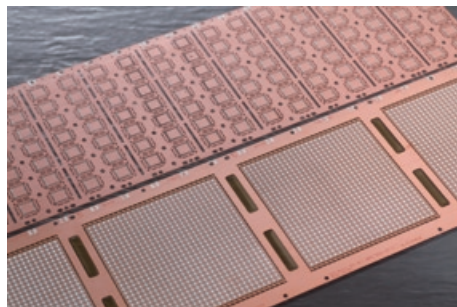
代表取締役社長

倉石文夫

# 部門別の状況

## ■ ICリードフレーム部門

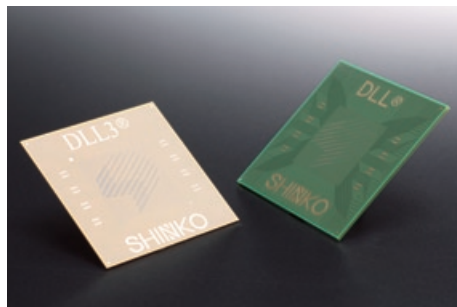
エッチングリードフレームは、QFN（クワッド・フラット・ノンリード）タイプ等、スマートフォン向けを中心に底堅く推移いたしました。一方、プレスリードフレームは、デジタル家電向けの需要低迷等により減収となり、また、メモリー向けのLOC（リード・オン・チップ）タイプリードフレームについても、厳しい受注環境が継続いたしました。この結果、当部門の売上高は231億20百万円（対前期比5.5%減）となりました。



QFNタイプリードフレーム

## ■ ICパッケージ部門

フリップチップタイプパッケージは、期前半の在庫調整の影響を大きく受けたことにより売上が減少し、また、プラスチックBGA（ボール・グリッド・アレイ）基板についても厳しい受注環境が継続いたしました。アセンブリ事業においては、カメラモジュール組立の売上が増加しましたが、その他の需要は低調に推移いたしました。一方、ヒートスプレッダーは、デスクトップ型パソコンやサーバー向けの需要が底堅く推移し売上が増加いたしました。この結果、当部門の売上高は889億54百万円（対前期比10.6%減）となりました。



フリップチップタイプパッケージ



## ■ 気密部品部門

光素子用ガラス端子は、デジタル家電向けの需要低迷などを背景として厳しい受注環境が続き、また、セラミック静電チャックについても半導体製造装置向けの需要が伸び悩み、いずれも前期比減収となりました。この結果、当部門の売上高は137億50百万円（対前期比19.2%減）となりました。



ガラス端子

## 部門別売上高構成

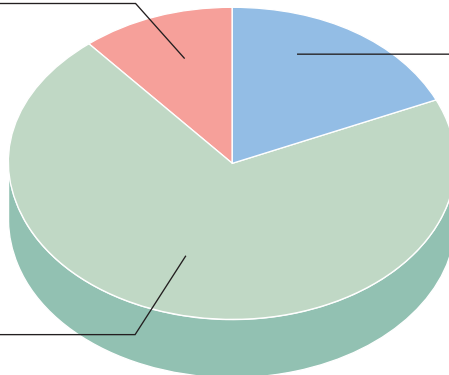
気密部品部門

137億50百万円（10.9%）

ICリードフレーム部門  
231億20百万円（18.4%）

ICパッケージ部門

889億54百万円（70.7%）

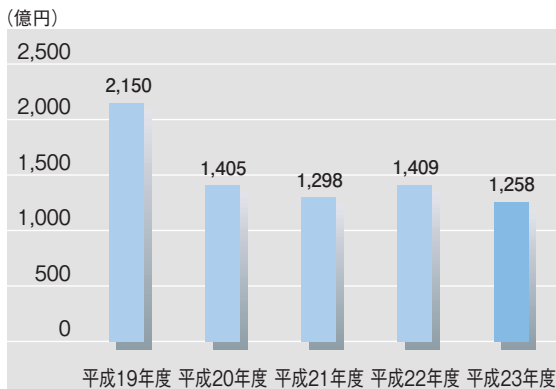


※（ ）内の数字は構成比率を表わしております。

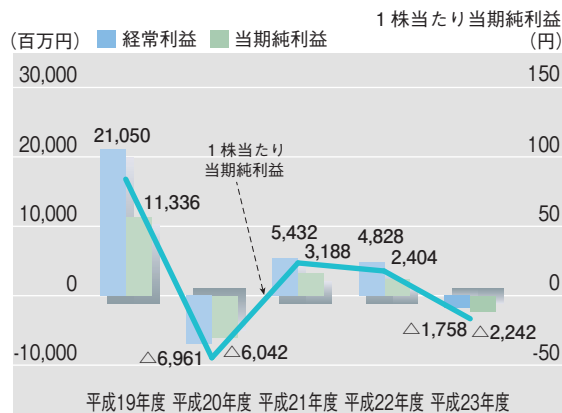
# 業績の推移

〔連結〕

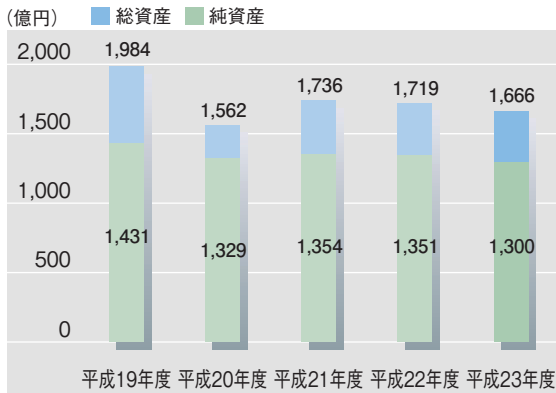
## ■ 売上高



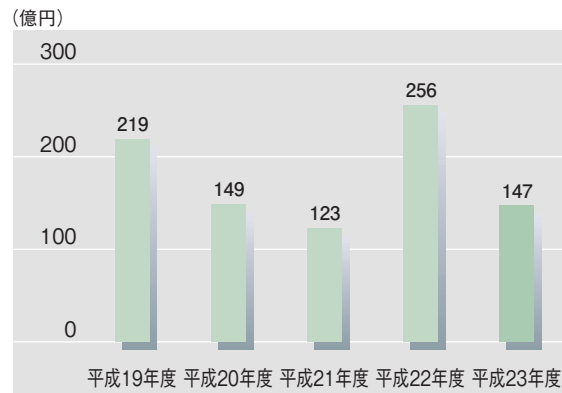
## ■ 経常利益 / 当期純利益



## ■ 総資産 / 純資産

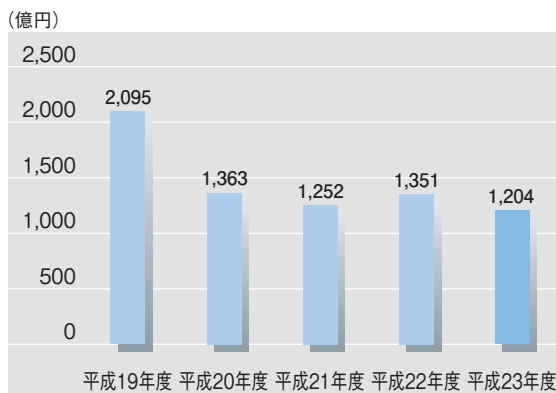


## ■ 設備投資

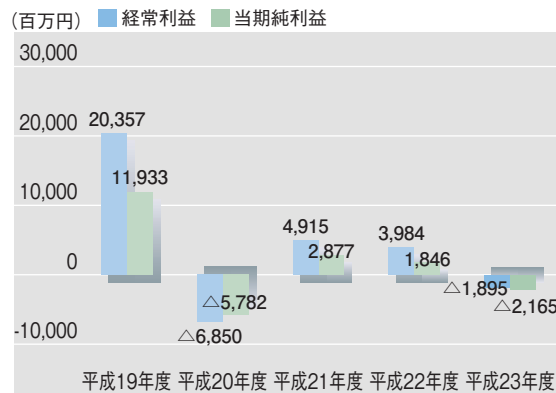


## 〔単独〕

## ■ 売上高



## ■ 経常利益 / 当期純利益



## ■ 営業成績および財産の状況の推移

区分	年度	平成19年度 〔第73期〕	平成20年度 〔第74期〕	平成21年度 〔第75期〕	平成22年度 〔第76期〕	平成23年度 〔第77期(当期)〕
----	----	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

## 〔連結〕

売上高 (百万円)	215,007	140,510	129,836	140,923	125,825
経常利益 (百万円)	21,050	△ 6,961	5,432	4,828	△ 1,758
当期純利益 (百万円)	11,336	△ 6,042	3,188	2,404	△ 2,242
1株当たり当期純利益	83円92銭	△ 44円73銭	23円60銭	17円80銭	△ 16円60銭
総資産 (百万円)	198,475	156,266	173,690	171,921	166,686
純資産 (百万円)	143,193	132,959	135,420	135,198	130,048
1株当たり純資産	1,059円98銭	984円22銭	1,002円45銭	1,000円80銭	962円68銭
設備投資 (百万円)	21,930	14,923	12,340	25,683	14,771
研究開発費 (百万円)	4,396	4,651	4,019	4,081	4,544

## 〔単独〕

売上高 (百万円)	209,582	136,336	125,232	135,161	120,438
経常利益 (百万円)	20,357	△ 6,850	4,915	3,984	△ 1,895
当期純利益 (百万円)	11,933	△ 5,782	2,877	1,846	△ 2,165

# 決算概要（連結）

## ■ 連結貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：百万円)

科目	当期	前期	科目	当期	前期
資産の部	166,686	171,921	負債の部	36,637	36,722
流動資産	99,645	106,863	流動負債	31,952	32,029
現金及び預金	15,835	23,625	買掛金	20,320	18,563
受取手形及び売掛金	37,926	31,185	短期借入金	600	600
有価証券	426	—	その他	11,032	12,866
商品及び製品	1,377	2,722	固定負債	4,685	4,692
仕掛品	3,666	3,721	純資産の部	130,048	135,198
原材料及び貯蔵品	1,222	1,232	株主資本	133,107	138,052
預け金	35,000	40,000	資本金	24,223	24,223
その他	4,217	4,379	資本剰余金	24,129	24,129
貸倒引当金	△ 25	△ 4	利益剰余金	84,847	89,791
固定資産	67,041	65,058	自己株式	△ 92	△ 92
有形固定資産	60,023	58,990	その他の包括利益累計額	△ 3,058	△ 2,853
無形固定資産	896	983	その他有価証券評価差額金	26	55
投資その他の資産	6,120	5,084	繰延ヘッジ損益	6	—
資産合計	166,686	171,921	為替換算調整勘定	△ 3,091	△ 2,908
			負債純資産合計	166,686	171,921



## ■ 連結損益計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：百万円)

科目	当期	前期
売上高	125,825	140,923
売上原価	117,966	124,614
売上総利益	7,859	16,309
販売費及び一般管理費	11,538	11,660
営業利益	△ 3,678	4,649
営業外収益	1,947	938
営業外費用	27	759
経常利益	△ 1,758	4,828
特別損失	467	727
税金等調整前当期純利益	△ 2,225	4,100
法人税、住民税及び事業税	256	326
法人税等調整額	△ 239	1,369
当期純利益	△ 2,242	2,404

## ■ 連結キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：百万円)

科目	当期	前期
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,664	26,172
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,169	△ 20,636
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,745	△ 2,226
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 78	△ 554
現金及び現金同等物の増減額	△ 12,329	2,754
現金及び現金同等物の期首残高	62,825	60,071
現金及び現金同等物の期末残高	50,496	62,825

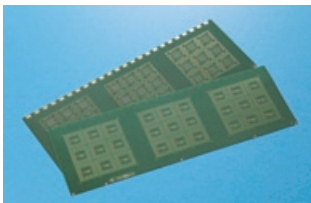
## ■ 連結株主資本等変動計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

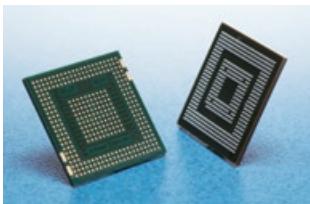
(単位：百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計	
平成23年4月1日残高	24,223	24,129	89,791	△ 92	138,052	55	—	△ 2,908	△ 2,853	135,198
連結会計年度中の変動額										
剰余金の配当			△ 2,701		△ 2,701					△ 2,701
当期純利益			△ 2,242		△ 2,242					△ 2,242
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)						△ 29	6	△ 182	△ 205	△ 205
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△ 4,944	—	△ 4,944	△ 29	6	△ 182	△ 205	△ 5,150
平成24年3月31日残高	24,223	24,129	84,847	△ 92	133,107	26	6	△ 3,091	△ 3,058	130,048

## 「より薄く、より軽く、高性能」を目指して



コアレス基板 (IVH3)



MCeP®

急速に市場を拡大するスマートフォンやタブレットPCは、様々な機能を備えて高性能化が進み、これを実現する高機能ICへのニーズもさらに高まっています。当社は、最先端の半導体実装技術により、これらのICを支える製品を開発・投入しています。

多層配線基板の中心層であるコア層を取り除いたコアレス基板は、電気特性に優れ、薄型・小型を実現する製品として、モバイル機器向けにも需要が増加しています。また、デバイス内蔵パッケージ「MCeP®」は、異なるデバイスを積み重ねて小型化をはかる3次元実装用のパッケージとして、一層の高密度化、薄型化を可能とし、スマートフォン等への需要拡大が期待されています。

## 高い信頼性でカーエレクトロニクスを支える

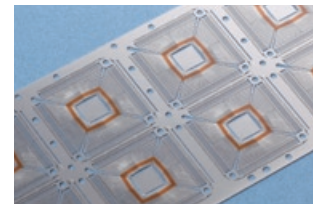
より安全・快適に、そして人と地球に優しい自動車を目指して、カーエレクトロニクス化が一層進み、今、自動車には数多くの電子部品が搭載されています。

この分野では、当社が半導体市場に進んで以来、長年にわたり手がけ、高い信頼性を有するガラス端子をはじめとして、メタルパッケージが幅広く使用され、さらに需要を伸ばしています。

「ハウジング」と呼ばれるセンサー用ガラス端子は、車体の安定性を保つためのブレーキコントロール用部品に、エンジンやブレーキの制御、カーナビゲーションシステム用のマイコンにはリードフレームが用いられています。



センサー用ガラス端子



リードフレーム

# 会社の概要

## Corporate Outline

(平成24年3月31日現在)

- 商号 新光電気工業株式会社
- 設立年月日 昭和21年9月12日
- 本社 長野県長野市小島田町80番地  
電話 (026) 283-1000 [代表]
- 主な事業内容 リードフレーム、プラスチック・ラミネート・パッケージ、ガラス端子、精密接触部品などの製造・販売、ICアセンブリ
- 従業員数 4,210名 (連結4,995名)
- 工場等 更北、若穂、高丘、新井、京ヶ瀬、新光開発センター、栗田総合センター
- 営業所等 東京、大阪、仙台、長野、名古屋、大分、福岡、フランクフルト、上海、成都、マニラ
- 子会社 新光パーツ株式会社  
新光テクノサブ株式会社  
SHINKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.  
韓国新光マイクロエレクトロニクス株式会社  
新光電気工業(無錫)有限公司  
SHINKO ELECTRIC AMERICA, INC.  
韓国新光商社株式会社  
台新電子股份有限公司  
SHINKO ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD.

## 取締役および監査役

(平成24年6月28日現在)

代表取締役会長	黒岩護
取締役副会長	藤本明
代表取締役社長	倉石文夫
取締役常務執行役員	浅野義博
取締役常務執行役員	清水満晴
取締役上席執行役員	依田稔久
取締役上席執行役員	長谷部浩
常勤監査役	小川喜彦
常勤監査役	酒井雄一
監査役	北澤光二

表紙：上高地（長野県松本市）

# 株式の状況

## Shareholders' Data

(平成24年3月31日現在)

- 発行可能株式総数 540,000,000株
- 発行済株式の総数 135,171,942株
- 資本金 24,223,020,480円
- 株主数 15,522名
- 大株主

株主名	所有株式数 (千株)	出資比率 (%)
富士通株式会社	67,587	50.00
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	6,838	5.06
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4,915	3.64
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ジャスディック・トリートイー・アカウント	4,389	3.25
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント	2,564	1.90
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 505103	2,556	1.89
株式会社八十二銀行	1,836	1.36
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	1,807	1.34
ニッポンベスト	1,350	1.00
朝日生命保険相互会社	1,239	0.92

## 執行役員

(平成24年6月28日現在)

常務執行役員	今井邦彦
上席執行役員	井口和治
上席執行役員	三井精造
上席執行役員	荻原俊彦
上席執行役員	清野貴博
上席執行役員	菊地貴人
執行役員	小林純一
執行役員	南沢克夫
執行役員	大日方政史
執行役員	小平正司
執行役員	反町東夫
執行役員	高柳秀則

## 株式事務のご案内

### ■株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

(連絡先)

〒100-8212  
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  
三菱UFJ信託銀行株式会社  
〒137-8081  
東京都江東区東砂七丁目10番11号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-232-711 (通話料無料)

### ■事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

### ■基準日

定時株主総会関係  
配当金受領株主確定日

3月31日  
3月31日および中間配当金の支払いを行う  
ときは9月30日

### ■公告方法

電子公告  
当社は、公告を下記ホームページに掲載して  
おります。

<http://www.shinko.co.jp/ir/kk/>

ただし、事故その他やむを得ない事由によっ  
て電子公告による公告をすることができない  
場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求その他の各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記の連絡先にお問い合わせください。三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町 80 番地

電話(026)283-1000〔代表〕FAX(026)284-8861

<http://www.shinko.co.jp>



地球環境に配慮した植物油  
インキを使用しています